

1. 適用範囲

バリャブルキャパシタに適用します。
LXRW0YV201-059



2. 特徴

- 入力電圧を調整することで、コンデンサの容量値を可変することができます。
- この製品は、FeliCa や NFC の周波数調整に使用されます。また、他のケースでも使用可能です。

3. 品番構成

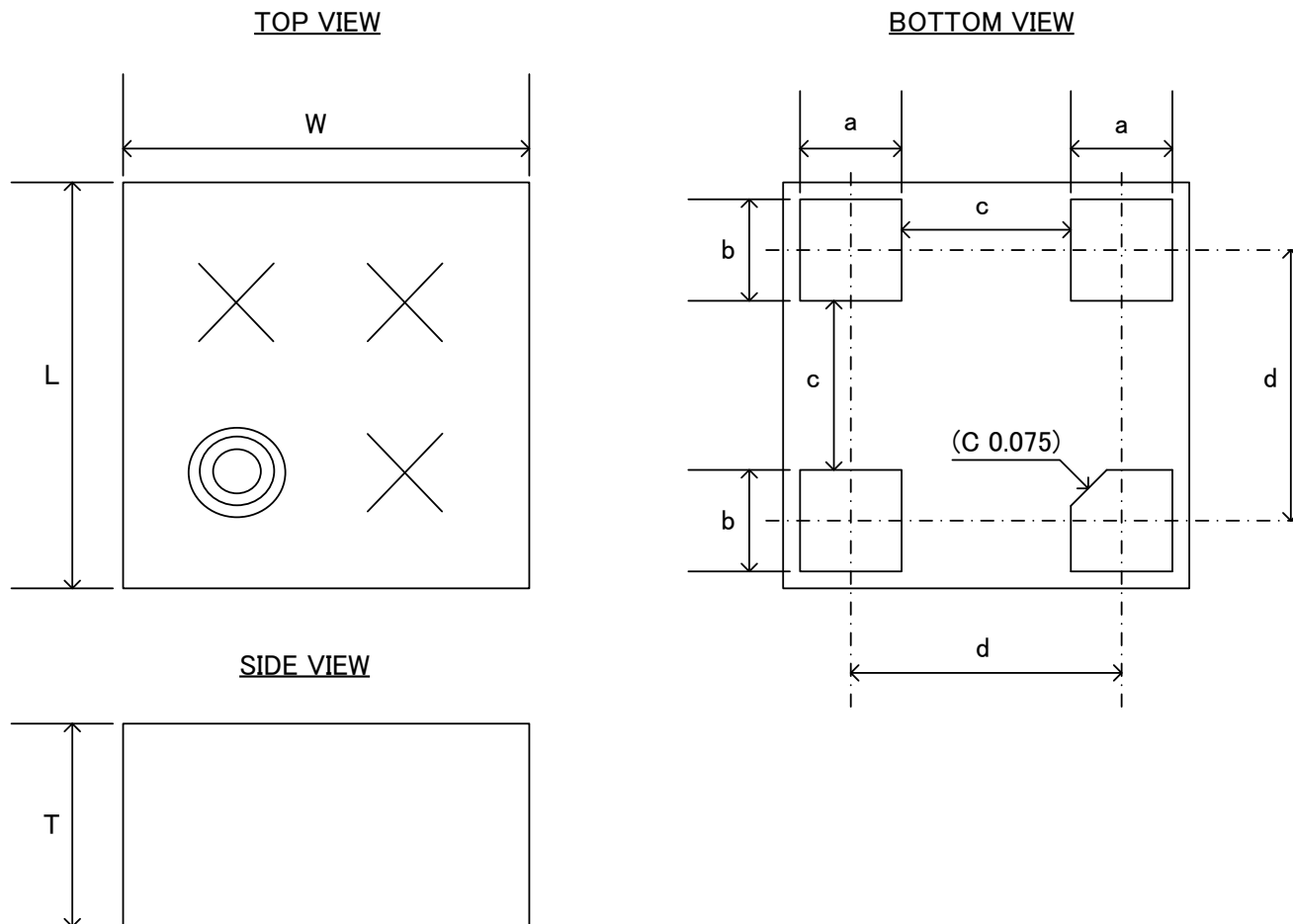
LXRW 0Y V 201 - 059
① ② ③ ④ ⑤

- ① 識別記号 (LXRW = Variable Capacitor)
- ② サイズ記号
- ③ 種類
- ④ 静電容量
- ⑤ 個別記号

※RoHS Compliant
MSL3
Halogen free
T/R only.

4. 構成・寸法

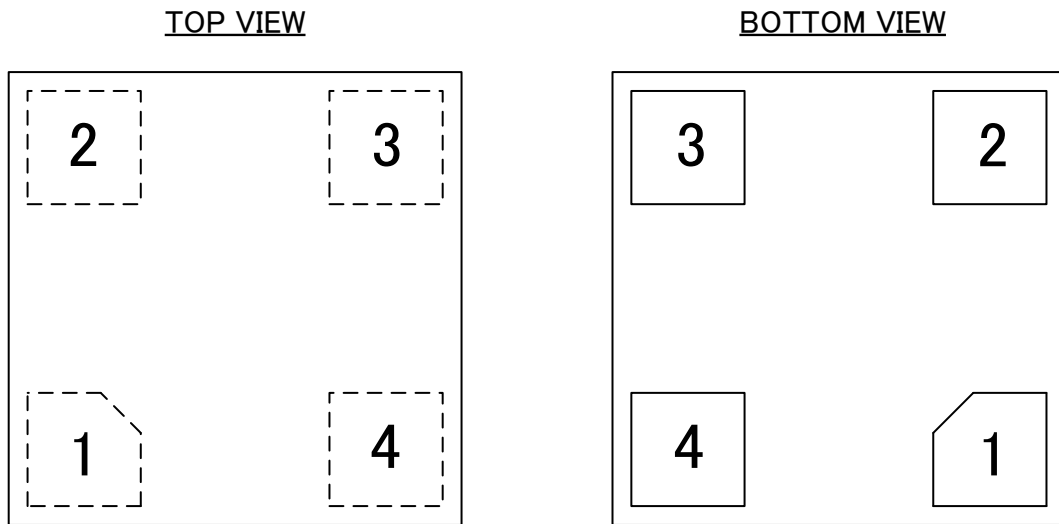
4-1 外形寸法



単位: mm

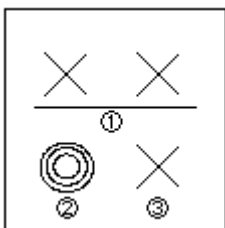
Mark	Size	Mark	Size
L	0.6 +/- 0.03	a	0.15 +/- 0.015
W	0.6 +/- 0.03	b	0.15 +/- 0.015
T	0.28 +/- 0.02	c	(0.25)
		d	(0.40)

4-2 端子構成



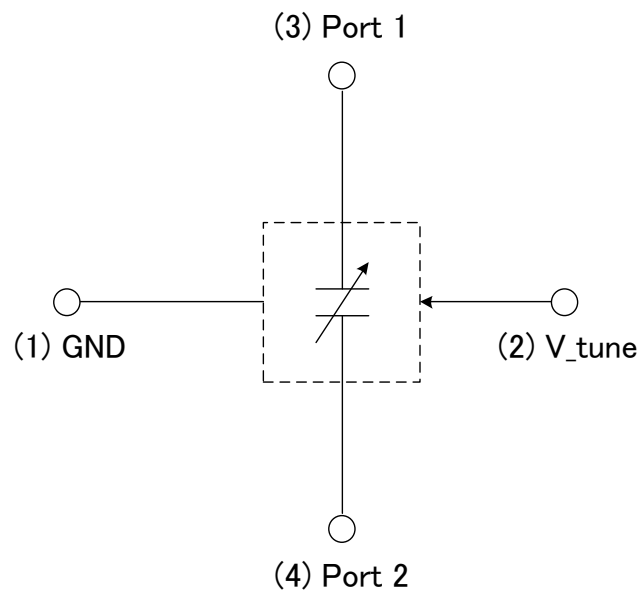
端子番号	端子記号	端子説明
1	GND	Ground
2	Vt	V_tune
3	Port1	RF port
4	Port2	RF port

5. マーキング



- ①トレースコード
- ②1ピンマーク
- ③デバイスコード

6. 等価回路



7. 特性

【電気的特性】

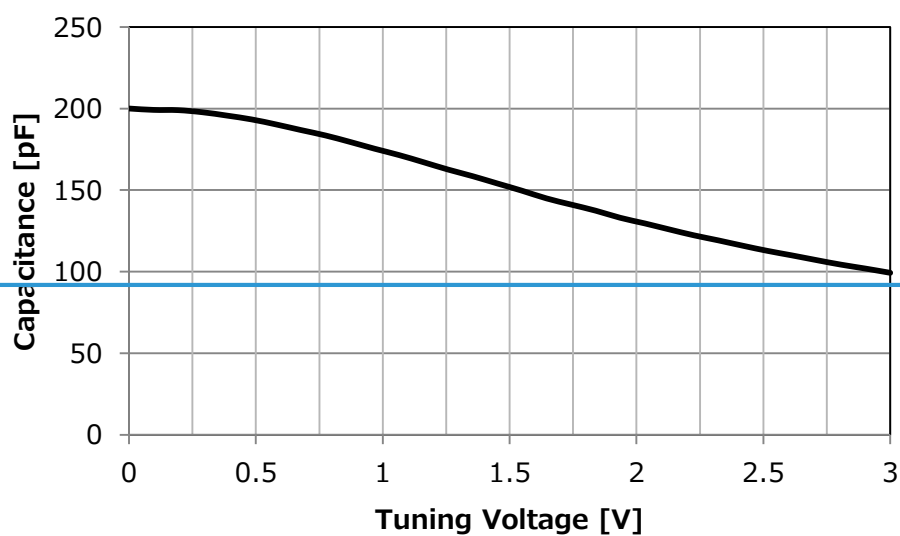
7-1. 定格

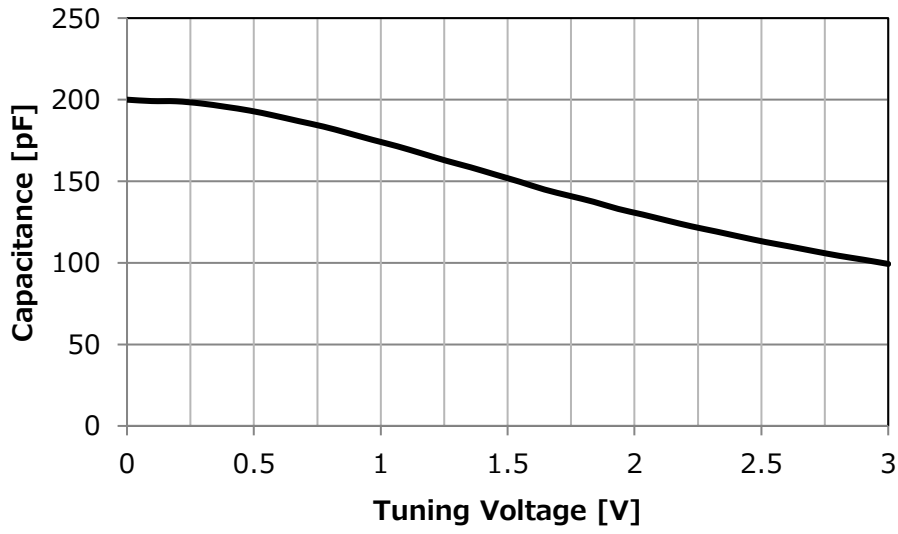
項目	記号	定格	単位
最大制御電圧	V_{dc}	3.2	V
AC 定格電圧(瞬時)	V_{aci}	50	Vp-p
動作温度	T_{OP}	-25 to +85	°C
保存温度	T_{STO}	-25 to +85	°C

7-2. 電気的特性 (T=25 +/- 5 °C)

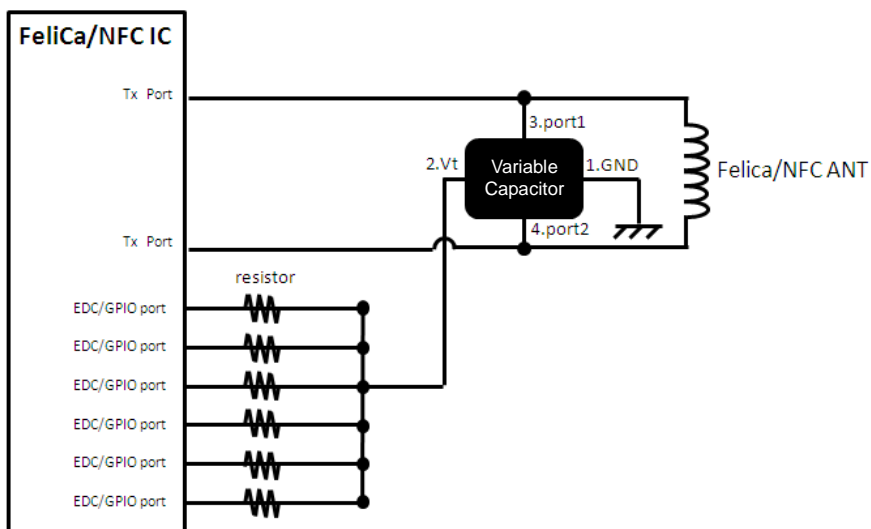
項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
容量値	C_{vc}	$V_T=0V$ $f=1MHz$		200		pF
		$V_T=3V$ $f=1MHz$		100		pF

8. 代表特性(参照目的のみ)





9. Application Circuit



抵抗値[Ω]	EDC/GPIO ポート数			
	3port	4port	5port	6port
R1	240K	180K	180K	180K
R2	510K	360K	360K	360K
R3	1M	750K	750K	750K
R4	-	1.5M	1.5M	1.5M
R5	-	-	3.0M	3.0M
R6	-	-	-	6.2M

10. 信頼性試験

【機械強度試験】

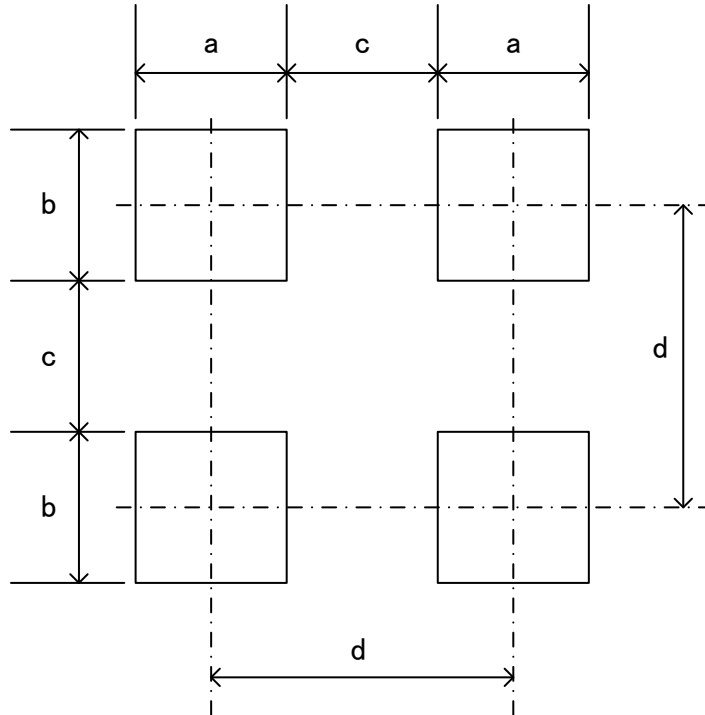
No.	項目	規格値	試験方法	数量	結果 (NG数)
1	耐振性	<ul style="list-style-type: none"> ・外観に著しい異常がないこと。 ・寸法規格値を満足すること。 	試料を付図1のランドパターンを有する試験治具にはんだ付けする。 周波数:10~2000 Hz 加速度:196 m/s ² 互いに垂直なる3方向に、2.5hづつ(計7.5h)行う。	22	G (0)
2	耐衝撃性		試料を付図1のランドパターンを有する試験治具にはんだ付けする。 パルス波形 : 正弦半波 ピーク加速度:981m/s ² 作業時間 :6 ms 試験回数 :6方向×各10回	22	G (0)
3	たわみ		試料を付図2の試験治具にはんだ付けする。 たわみ量:1.6mm	22	G (0)
4	端子電極固着力	<ul style="list-style-type: none"> ・限界値が2N以上を満足すること。 	試料を下図試験治具にはんだ付けし、荷重速度約0.5 mm/sで加圧治具を用いて、外部電極が剥離または、デバイスが破壊するまで荷重を加える。加圧方向は、下図のL方向とする。 <div style="text-align: center;"> <p>加圧方向</p>  </div>	22	G (0)
5	はんだ付け性	<ul style="list-style-type: none"> ・端子電極の95%以上に切れ目なく、はんだが付着すること。 	予熱:150℃, 60s はんだの種類:Sn-3.0Ag-0.5Cu フラックス:ロソンのエタノール溶液(25 wt%) はんだ温度:245±5℃ 浸せき時間:3±0.5 s 浸せき位置:端子電極が隠れるところまで。	22	G (0)

No.	項目	規格値	試験方法	数量	結果 (NG数)
6	はんだ耐熱性 (リフロー)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観に著しい異常がないこと。 ・寸法規格値を満足すること。 ・7-2 項の電気的特性を満足すること。 	予熱温度:150~200 °C 予熱時間:60~120 s 高温時間:217°C 60~150 s ピーク温度:255~260 °C 上記条件で2 回行い、常温常湿に取り出し24 h 後に測定する。	22	G (0)
7	マウント衝撃試験	<ul style="list-style-type: none"> ・外観に著しい異常がないこと。 ・寸法規格値を満足すること。 ・7-2 項の電気的特性を満足すること。 	ノズル: Buffing Nozzle (衝撃吸収機構) 直径 (vacuum): $\phi 0.4$ mm 押し込み量: +0.4 mm 荷重:13 N(max)	22	G (0)

【環境試験】

No.	項目	規格値	試験方法	数量	結果 (NG数)									
8	高温放置	<ul style="list-style-type: none"> ・外観に著しい異常がないこと。 ・寸法規格値を満足すること。 ・4-2項の電気的特性を満足すること。 	温度:85±2 °C 試験時間:500+48/-0 h 放置時間:2 ~ 24 h	22	G (0)									
9	温度サイクル		試験条件:下表を100 サイクル <table border="1" data-bbox="837 1142 1236 1377"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温度 (°C)</th> <th>時間 (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>最低使用 温度+0/-3°C</td> <td>30±3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>最高使用 温度+3/-0°C</td> <td>30±3</td> </tr> </tbody> </table>	段階	温度 (°C)	時間 (min)	1	最低使用 温度+0/-3°C	30±3	2	最高使用 温度+3/-0°C	30±3	22	G (0)
段階	温度 (°C)		時間 (min)											
1	最低使用 温度+0/-3°C	30±3												
2	最高使用 温度+3/-0°C	30±3												
10	湿中放置	温度:40±2 °C 湿度:80~90 %RH 試験時間:500±12 h 放置時間:2 ~ 24h	22	G (0)										
11	低温放置	温度:-40±2 °C 試験時間:500+48/-0 h 放置時間:2 ~ 24 h	22	G (0)										
12	静電気耐圧 (Machine Model)		放電抵抗:0 Ω 試験電圧:±200V (Port1、Port2、Vt)、0V (GND) 印加回数:各1 回 充電用コンデンサ:200pF	10	G (0)									
13	静電気耐圧 (Human Body Model)		放電抵抗:1500 Ω 試験電圧:±400V (Port1、Port2、Vt)、0V (GND) 印加回数:各1 回 充電用コンデンサ:100pF	10	G (0)									

付図. 1
推奨ランドパターン

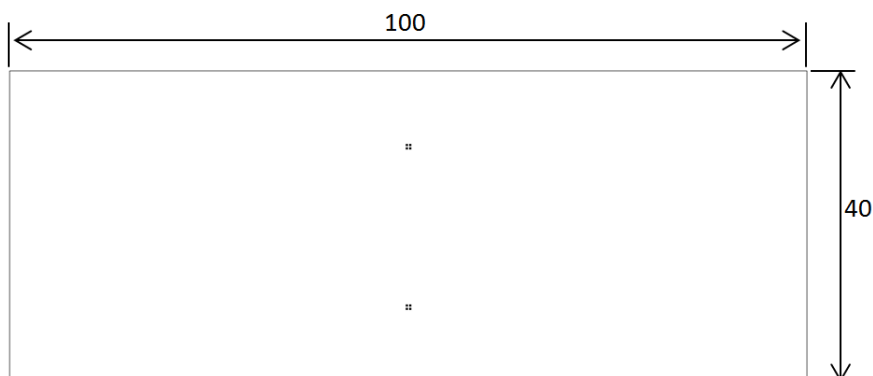


単位: mm

Mark	Size	Mark	Size
a	0.20	c	(0.2)
b	0.20	d	(0.4)

This land pattern is for reference purpose only.

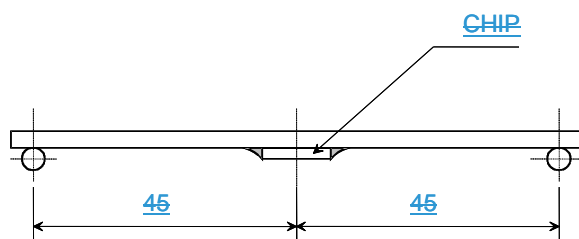
Fig. 2
試験用基板



(単位 : mm)

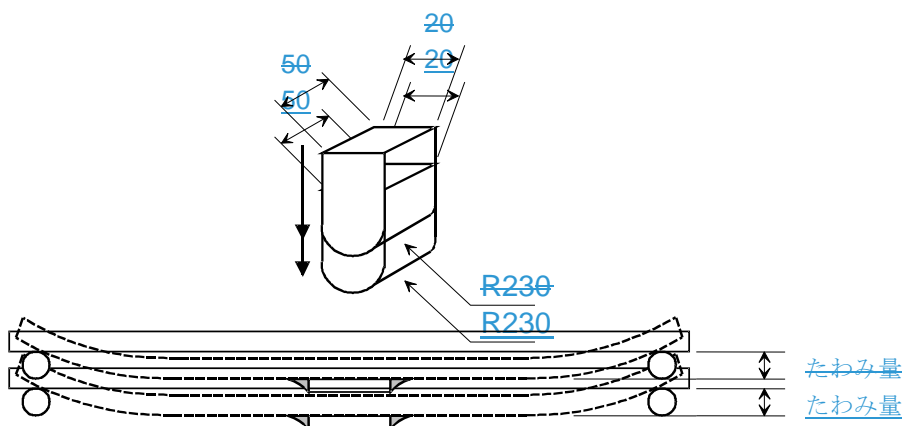
■ランド
ランド寸法は付図 1 による。
ガラスエポキシ基板 t=1.6mm
銅箔 35um 以上

実装状態



(単位 : mm)

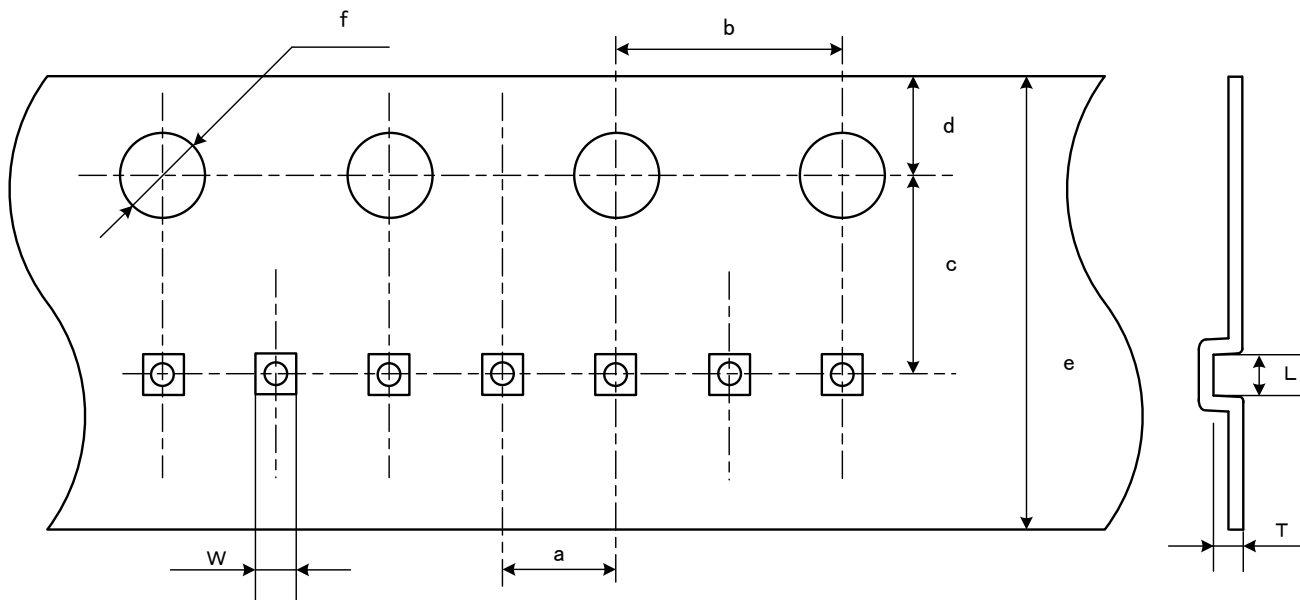
試験方法



(単位 : mm)

11. 包装仕様

11-1. テーピング寸法図



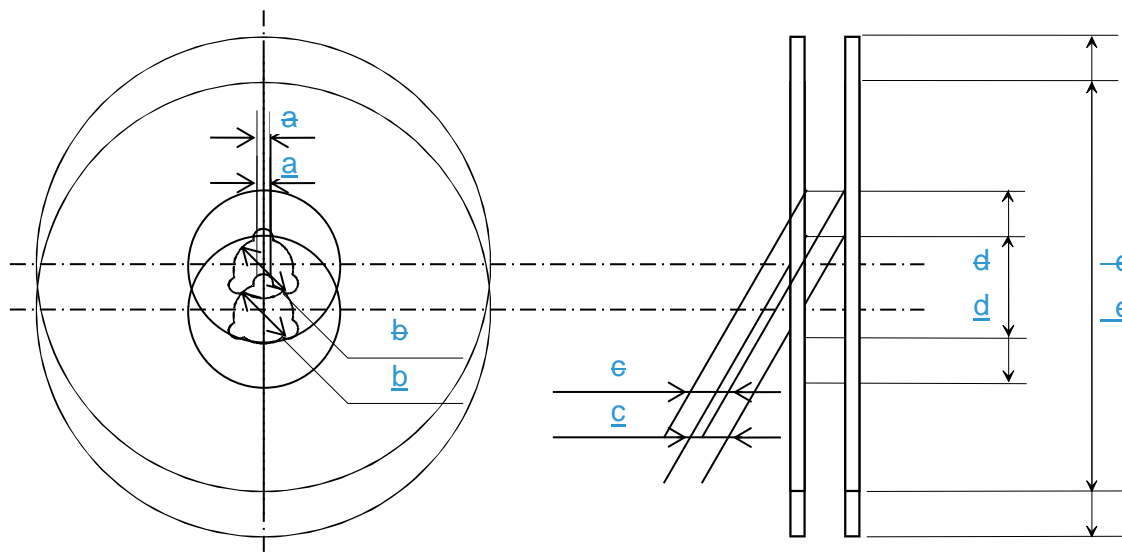
→ 引き出し方向

(単位 : mm)

Symbol	L	W	T	a	b	c	d	e	f
Size	0.68+/-0.03	0.68+/-0.03	0.33+/-0.03	2.0+/-0.05	4.0+/-0.1	(3.50)	1.75+/-0.1	8.0+/-0.2	$\phi 1.5+/-0.1$

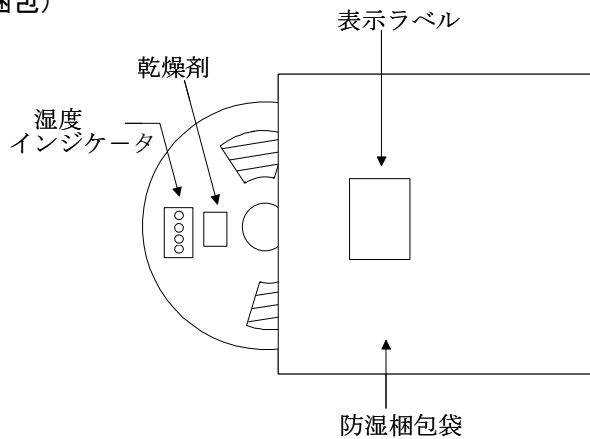
11-2. リール寸法図

(単位 : mm)



Symbol	a	b	c	d	単位 e mm
Size	1.5 min	$\phi 13.0+/-0.2$	(9.0)	$\phi 60$	$\phi 180$

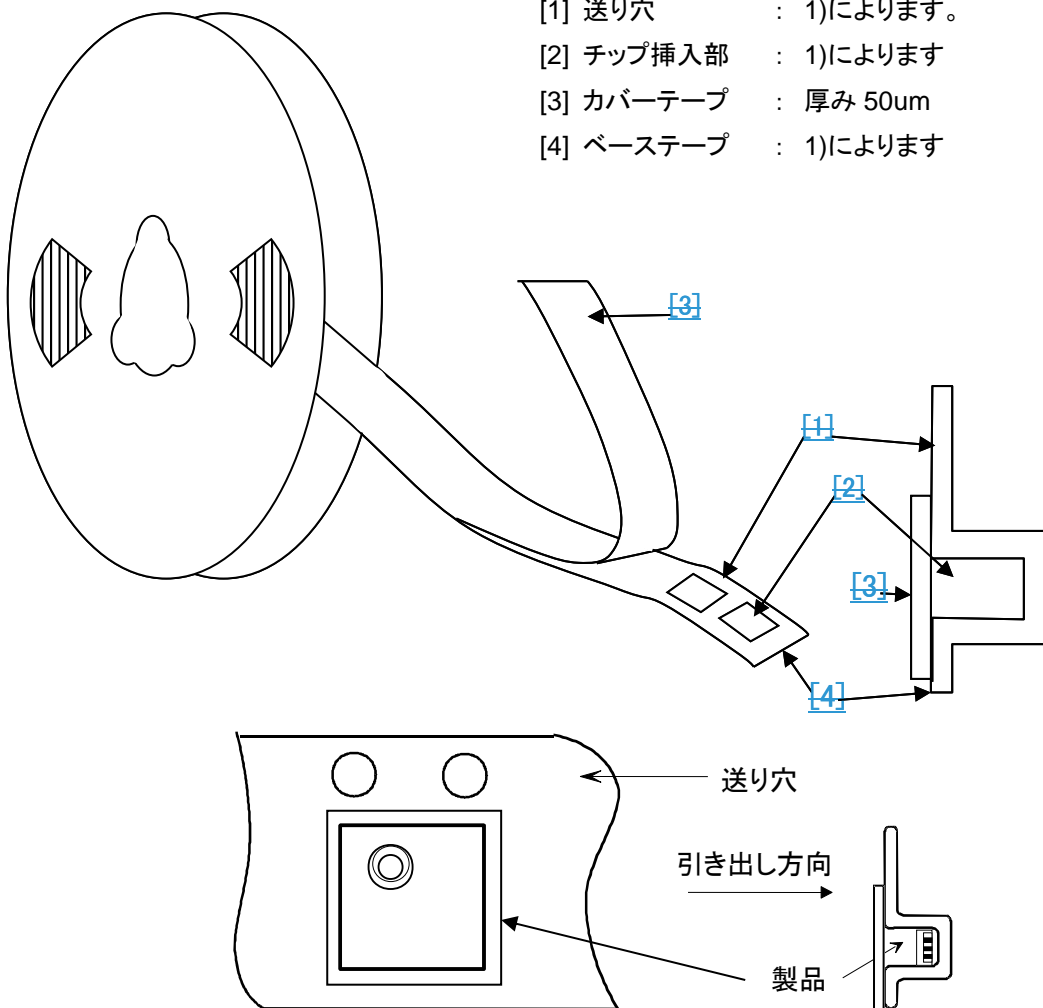
11-3. 梱包(防湿梱包)



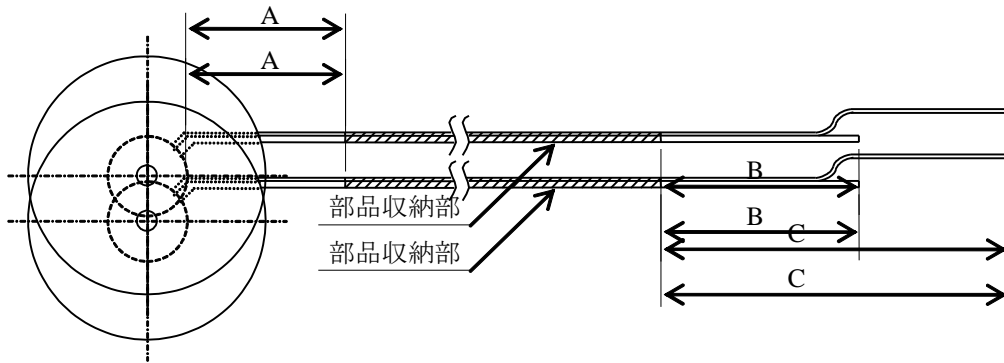
(アルミラミネート材)

リールは防湿梱包材に入れ、乾燥剤と湿度インジケータを同封しヒートシールします。
1つのリールに対して1つの防湿梱包袋を使用します。(複数リールを1つの防湿梱包袋で梱包しません。)

11-4. テーピング図



11-5. テープのリーダー部およびテレーラー部



記号	項目	寸法(mm)
A	トレイラー部空部	160 以上
B	リーダー部空部全体	100 以上
C	リーダー部全体	400 以上

11-6. テープのテーピングは、右巻きとします。

(テープの先端を手前に取り出したとき、送り穴が右側となります。)

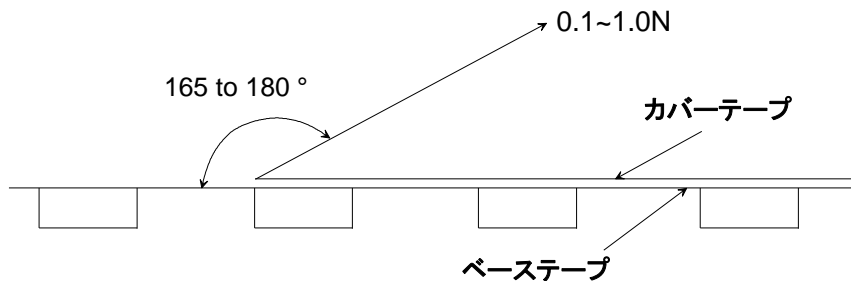
11-7. 1リールあたりのチップ数量 : 10,000 個/リール

11-8. 包装材料: ベーステープ ... 樹脂製
リール ... 樹脂製

ベーステープ, リール, トップテープは帯電防止処理加工を施しております。

11-9. カバーテープの剥離強度は、0.1~1.0N以下です。

この時の剥離方法は、下図の通りです。



使用上の注意

1. 貯蔵・保管上の注意:

外部電極のはんだ付け性を損なわないため、製品の貯蔵・保管に際しては、以下の条件にて行ってください。

- 当製品は、防湿梱包未開封の状態、周囲温度 5°C~35°C、湿度 20~70%RH 以下で保管してください。
(梱包材料は 40°C を超えますと変形することがあります。)
粘着テープ、エンボステープ、リールは耐熱仕様ではありません。テーピング状態でのベーキングはできません。ベーキング処理を行う場合は、耐熱性容器に移し替えるなどして行ってください。ベーキングの条件は、125°C、24時間、1回までとして下さい。やむを得ずテーピング状態でベーキング処理を行う場合は 60°C、10%RH 以下、72 時間、3 回までとして下さい。また、テーピング状態でのベーキングを行うとカバーテープの剥離強度が増加する可能性があります。ご使用前にご確認いただき、実装機の調整をお願いします。また、ベーキングの際、およびベーキング完了後の温度降下の際、テーピングに負荷を掛けますと変形する場合がありますのでご注意ください。
- 開封後の保管は、周囲温度 5~30°C、湿度 60%RH 以下の環境で 168 時間以内、または 30°C、10%RH 以下の環境で 6 ヶ月以内として下さい。ただし、御社受領後 6 カ月を経過したものに関しては、半田付け性を確認のうえご使用下さい。
- 高温多湿や温度変化の激しい場所では、製品に結露を生じたり、特性劣化、半田付け性劣化を招く原因となります。
- 大気中に硫黄や塩素などを含んだ腐食性ガスの存在しないところに保管して下さい。
- 防湿梱包袋には、乾燥剤と湿度インジケータを同封しています。このインジケータが変色している場合は、梱包材が破れるなどして製品が吸湿している可能性があります。この場合は、リフロー前にベーキング処理を行ってください。
- 当製品は MSL3 です。(Based on JEDEC Standard J-STD-020)

2. 取り扱い上の注意

- 過度の押圧、衝撃により製品が破壊することがありますので、輸送時や取り扱い時にはご注意ください。
- 製品の電極が傷ついたり、かけたりしますと性能が変化する可能性がありますので、取り扱いにはご注意下さい。また、素手で端子等を触りますと、半田付け性低下の原因となりますので、素手で製品に触ることのないようご注意下さい。

3. 基板設計(ランド寸法)

- グランド端子は、全てグランドパターンに接続してご使用下さい。標準的なランド寸法は付図.1 の通りです。
- 当推奨ランド、パターン寸法は、弊社の標準のもので、実機実装状態では、周辺のシールド・その他部品の配置およびパターンの引き方・グランドの取り方・グランドの強さ・NC端子の取り付けランドの有無・寸法・基板の種類・厚みなどにより特性が変動する場合があります。
- 付図.1 のランド以外でご使用になる場合は、必ず実機実装状態での特性を確認して下さい。

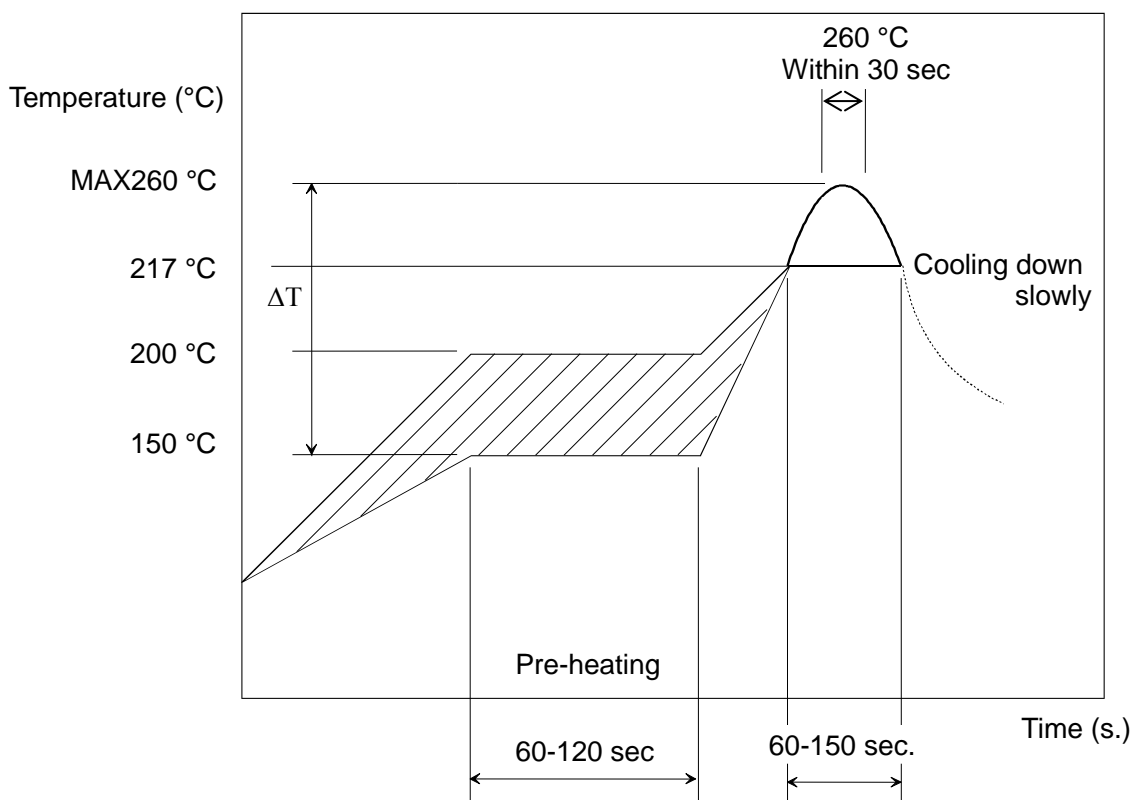
4. チッププレーサーによる機械衝撃について

- 当チップ部品を基板に実装される際、吸着ノズル機構部分などが摩耗していると、チップ部品に異常な衝撃が加わり、チップ部品を破壊することがあります。この種のトラブルを未然に防止するためにも、実装機に推奨されている定期メンテナンスを実施して下さい。位置決めのための機械的チャッキングはおこなわないで下さい。

5. はんだ付け条件

- ・はんだ付けは、2 回を超えて行わないでください。
 - ・はんだ温度と部品表面の温度差 (ΔT) が 130°C 以下となるよう十分な予熱を行って下さい。また、取り付け後、溶剤への浸漬などより急冷される場合は、温度差が 100°C 以内となるよう配慮して下さい。
- 当製品は、上記はんだ付け条件以外で使用される場合、製品に損傷を与える場合がございます。(外部電極くわれ、クラックなど) 当条件以外でご使用になる場合は、あらかじめ弊社にご連絡下さい。

リフローはんだ付け条件



リフロー雰囲気: N2

- ・フラックスをご使用になる場合は、ロジン系のフラックスまたは、塩素含有率 0.2wt% 以下の弱活性フラックスを使用して下さい。また、製品の周囲にフラックスの残渣が残らないようにご使用下さい。フラックス残渣により特性劣化、絶縁抵抗の低下の可能性がございます。

6. 洗浄

- ・ 洗浄は行えません。無洗浄タイプのフラックス等のご使用をお願いいたします。

7. 使用について

- ・ 当製品は一般的環境下(常温・常湿・常圧の雰囲気内)で使用される電子機器等でのご使用をもとに設計しておりますので、これに類する環境下でのご使用には問題ありません。しかし、以下に示します環境でご使用されますと、当製品が劣化し、感電や焼損の原因となります。
 - ・特殊ガス雰囲気(Cl₂、NH₃、SOX、NOX など)
 - ・揮発性、引火性のあるガス雰囲気
 - ・塵埃の多い環境
 - ・水が直接かかる環境、結露しやすい環境、直射日光が当たる環境、凍結する環境。
- ・ 当製品のご使用にあたって前項に示す事柄の可能性のある場合には、あらかじめ弊社までご相談下さい。
- ・ 当製品に静電気を加えると劣化及び破壊を生じる事がありますので、組立、測定作業時静電気や過電圧が加わらないよう十分配慮の上、御使用下さい。
- ・ いかなる場合であっても、本製品の不具合により、人命、身体への損害およびその他の重大な損害の発生が予見される場合は、下記の方法でフェールセーフ設計への配慮を十分に行い、安全性を確保をお願いします。
 - ① 保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する
 - ② 冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

8. 用途の限定

当製品は一般的な電子機器(AV 機器、OA 機器、通信機器など)への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が身体への損害、人命、財産に危害を及ぼす恐れ、またはその他の重大な損害の発生にかかわるような以下の機器または装置等へのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡下さい。

- ・航空機器
- ・宇宙機器
- ・海底機器
- ・発電所制御機器
- ・医療機器
- ・輸送機器(自動車, 列車, 船舶等)
- ・交通用信号機器
- ・防災/防犯機器
- ・情報処理機器
- ・その他上記機器と同等の機器

 **お願い**

- ・本製品は、基板への取り付け状態(パターンの引き方、グラウンドの取り方等)によって電氣的性能が変動する場合があります。ご使用に際しては、御社製品に実装された状態で必ず評価・確認をして下さい。
- ・当データシートの記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認下さい。
- ・当データシートには、紙面に都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。